

第 40 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:令和 4 年 11 月 29 日(火) 13:30~17:20

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室 (東京都中央区)

時 間	題 目	講 演 者
	司会 岩田 剛治 (大阪大学)	
13:30~ 14:10	『統計解析と機械学習を活用した 高鉛はんだ接合条件の効率的探索』 (40 分)	○荻谷 健人 浮田 昌也 大塚 拓一 中原 健(ローム(株))
14:10~ 14:50	『トポロジー最適化によるデバイス設計と 産業展開に向けた試み』 (40 分)	○山田 崇恭(東京大学)
14:50~ 15:30	『半導体パッケージの研究開発における 数値流体解析(CFD)の活用』 (40 分)	○宮澤 理沙 (日本アイ・ビー・エム(株))
15:30~ 15:40	休 憩	
	司会 出田 吾朗(三菱電機(株))	
15:40~ 16:30	『グラビアオフセット印刷法による マイクロはんだバンプの形成』 (40 分)	○池田 英樹((株)小森コーポレーション)
16:30~ 17:10	『結晶構造解析を用いた超音波接合部の 新たな評価手法の検討』 (40 分)	○伊藤 宜司 相澤 隆博 浮田 康成((株)東芝) 佐藤 裕(東北大学)
17:10~ 17:20	委 員 会 議 事	

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。